

第33回エレクトロニクス実装学会春季講演大会プログラム(暫定)
会期:平成31年3月11日(月)~13日(水) 会場:拓殖大学文京キャンパス
講演セッション 第1日目(3月11日)

	【A会場】	【B会場】	【C会場】	【D会場】	【E会場】
10:30	【官能検査システム化技術】 11A1-01 機械学習による外観検査への取り組み 根本 大樹1、○永田 毅1、2 1.みずほ情報総研、2.筑波大学グローバル教育院	【電子部品・プリントフレキシブルデバイス実装】 11B1-01 Cuピラー接合用の焼結Cu接合材 ○谷中 勇一、中子 偉夫、須藤 千雄、川名 祐貴、榎岸 征夫、江尻 剛1 日立化成株式会社 11B1-02【】 フィルム型接続技術によるフレキシブル部品実装 ○三井 亮介、後藤 理恵、佐藤 卓也、吉良 敦史、中島 伸一郎 日本航空電子工業			【チュートリアルセッション】 ①電子機器における電子回路実装の重要性(40分) 羽原 孝(積研大教授) (10時30分から11時まで)
11:00	11A1-02 機械学習を用いた外観検査に対するDOGANIによる学習データ生成 ○西谷 一希、茂木 和弘、白石 洋一 群馬大学	11B1-03 「エッチング工程を必要としない環境配慮型プリント基板製造工法の開発 -6-」 ○本田 謙児1、鈴木 治行1、松本 享1、加東 隆2、山口 範博3、藤川 良太3、丸澤 尚4、宮内 映奈4、樋野 進一5、加藤 義尚6 1.アサダメッシュ、2.奥野製薬工業、3.タツタ電線、4.互応化学工業、5.HINO実装設計、6.福岡大学 半導体実装研究所			②エレクトロニクス実装を支える材料及び接合技術(45分) 八重香 明彦(東大) (11時から11時45分まで)
11:15	11A1-03 テクスチャパターン識別法の考察と提案 ○原 謙彦1、田中 宏幸1、白井 健二1、菅野 純一2、細島 侑2、滝沢 義信2 1.日本大学、2.ヴィスコテクノロジーズ	11B1-04 MEMSプロセスを用いた樹脂-金属複合立体電極の形成 ○水野 英明1、安澤 真一1、飯田 祐介1、米久保 荘1、佐藤 彰2、下島 博文 1.長野県工業技術総合センター、2.テクノロジイノベーション			
11:30	11A1-04 耐プラズマ性部材のパーティクルコンタミネーション評価 ○滝沢 亮人、芦澤 宏明、清原 正勝 TOTO株式会社	11B1-05 AM技術を用いた三次元配線形成に関する研究 ○森 三樹、新野 俊樹、渡邊 哲也 東京大学			
11:45	11A1-05 薄型AEセンサとサポートベクトルマシンを用いたワイヤボンディングテストにおける破断モード推定 ○小石 泰毅1、石田 秀一2、田原 竜夫2、岩崎 涉2、宮本 弘一1 1.九州工業大学大学院 2.産業技術総合研究所				

昼休み

13:00	JSAP・JIEP協業特別シンポジウム ★ 急加速するクルマの電動化★ ・JSAP財団会長・JIEP益会長 趣旨説明 ○車の電動化・知能化に向けた実装技術動向と品質課題 ・堀井良和(日産自動車)	【配線板とその製造技術①】 11B2-01 基材選択性に優れたダイレクトめっきプロセスの特性評価 ○村田 拓也、山本 久光、石田 哲司 上村工業 11B2-02 ピア底部の結晶連続性に対する無電解めっきプロセスの ○北原 悠平、妻 俊行 奥野製薬工業株式会社 11B2-03 銀をシード層としたセミアティープ法による銅配線形成 ○村川 昭、新林 昭太、深澤 憲正、富士川 亘、白髪 潤 DIC 11B2-04 低真空スパッタによるガラス上への回路形成を目的とした高 密度銅シード膜 ○上山 浩幸1、猿渡 哲也1、吉岡 尚規1、Cordonier Christopher EJ2、渡邊 充広2 1.株式会社島津製作所、2.関東学院大学 材料・表面工学研 究所	【ものづくりセッション(1)】 11C2-01 液浸冷却技術を活用した耐環境電子機器の開発 ○山田 哲郎、魏 杰、増田 泰志、山本 剛 富士通アドバンステクノロジー株式会社 11C2-02 新規銀ナノ粒子ペーストによる高耐熱接合の開発 ○長澤 浩1、中島 啓光3、雨宮 隆2、伊藤 公紀1 1.株式会社 環境レジリエンス、2.横浜国立大学、3.電気通信 大学 11C2-03 引張せん断試験中の温湿度環境が接着強度に与える影響 評価 ○菊池 郁雄、渡 遥、牧 大輔、田中 浩和 エスベック株式会社	【高速伝送実装①】 11D2-01 次世代映像システムの実現に向けた画素単位の3次元集積 化技術と高機能イメージセンサの開発 ○後藤 正英1 1.NHK放送技術研究所 11D2-02 スイッチング電源基板設計をテーマとした実装型講座の新規 開発 ○高橋 成正1、東 正登2、庄林 雅了2 1.株式会社トータス、2.近畿職業能力開発大学校 11D2-03 平衡形円板共振器法を用いる導体銅板のミリ波導電率測定 ○小林 福夫、小林 創太郎 サムテック有限会社 11D2-04 ミリ波帯におけるアンテナの高精度測定について ○朝倉 克哉1、和泉 峻介1、前山 利幸1、常光 康弘1、田中 稔泰2 1.拓殖大学、2.マイクロウェーブファクトリー株式会社 11D2-05 センサ用ワイヤレスエネルギーハーベスティング回路 ○島中 駿介、金谷 晴一 九州大学	③IoTとマイニングを加速する半導体・実装設計(45分) 井上博文(井上技術士) (13時から13時45分まで)
13:30					
13:45					④IoT-16システム実装に必要なプリント配線板の技術(45分) 高木 清(YJG) (13時45分から14時30分まで)
14:00	○デンソーにおける車両の電動化技術 ・田中政一(デンソー)	11B2-05 平滑ガラス上への湿式銅めっき用密着増強処理の紹介 ○桑原 京平 アトテックジャパン株式会社			
14:15	○電動車に向けた全固体電池の開発動向 ・高田和典(物材機構)				
14:30					
14:45					
15:00					

ポスターセッション コアタイム(14:30から15:30)

15:30	○クルマの電動化で求められるパワーデバイス性能とSiCパ ハイスによる性能向上への期待 ・寺島知秀(三菱電機)	【配線板とその製造技術②】 11B3-01 プリント配線板のセミアティープ工程におけるエッチングプロ セスの電気的信頼性に与える影響—交流インピーダンスによ る解析 ○茂手木 慶1、吉原 佐知雄1、清野 正三2、谷本 樹一2 1.宇都宮大学、2.JCU 11B3-02 原子層堆積法による酸化アルミニウム膜を用いた高信頼性 Cu配線技術の開発 ○山崎 智生 新光電気工業株式会社 11B3-03 サブミクロン領域のチップ間接続配線における信頼性試験と メカニズム解析 ○森田 将、池田 淳也、中田 義弘 1.株式会社富士通研究所 11B3-04 高密度ランドレスプリント配線板の設計優位性の検討 ○浦西 泰弘1 1.一般 11B3-05 高機能ランドレスプリント配線板の電気的優位性の検討 ○前田 真一 KEI Systems	【材料技術・環境調和型実装技術】 11C3-01 マテリアルズ・インフォマティクスを活用した高密封界面の高 効率設計 ○岩崎 富生 日立製作所 11C3-02 銀フィラー表面吸着分子によって引き起こされる導電性接着 剤の導電バス発達促進現象 ○井上 雅博、榎岸 智仁 群馬大学 11C3-03 無電解めっきアルミニウム粉末の作製と評価 ○中谷 敏雄、南 和哉、南山 偉明、橋本 良樹 東洋アルミニウム株式会社 11C3-04 エポキシバインダ中の銀マイクロ粒子の低温焼結誘導におけ る化学的因子の影響 ○中澤 史穂、井上 雅博 群馬大学 11C3-05 シリコーンオリゴマーを用いた回路形成例及び伝送評価(~ 50GHz) ○佐土原 大祐1、相島 博之2、韓 榮建3、加藤 義尚3 1.株式会社JCU、2.福岡県産業・科学技術振興財団 三次元 半導体研究センター、3.福岡大学	【高速伝送実装②】 11D3-01 平面コイルを用いた無線電力伝送回路の解析 ○菊池 秀雄、中島 彰泰、白石 洋一、茂木 和弘 群馬大学 11D3-02 モーメント法を用いた高周波電流測定用ロコスキーコイルの 設計 ○南川 和正1、桑原 伸夫1、福本 幸弘1、松嶋 徹1、脇坂 俊 幸2 1.九州工業大学、2.パナソニック(株) 11D3-03 磁性体を用いた経皮エネルギー伝送用コイルの検討—位置 ずれに対する伝送特性と磁束密度分布の検討— ○佐藤 潤弥1、越地 福嗣1、越地 耕二2 1.東京工業大学、2.東京理科大学 11D3-04 人体通信における電極配置に対する伝送特性の検討 ○望月 幹太1、越地 福嗣1、越地 耕二2 1.東京工業大学、2.東京理科大学 11D3-05 28GHz帯アンテナ実装に関する一検討 ○和泉 峻介1、朝倉 克哉1、前山 利幸1、常光 康弘1、田中 稔泰2 1.拓殖大学、2.マイクロウェーブファクトリー株式会社 11D3-06 単方向指向性28GHz帯5G小型高利得平面アンテナの開発 ○井出 卓宏、金谷 晴一 九州大学大学院	⑤電子機器の小型・高機能化、応用拡大で半導体・電子部品・基板実装技 術が変化する！ (45分) 本多 進(YJG) (15時から15時45分まで)
15:45	○電動車向けパワーモジュールの実装技術 ・門口卓矢(トヨタ自動車)				⑥80年代の実装技術(45分) 宮代文夫(YJG) (15時45分から16時30分まで)
16:00					
16:15					
16:30	○SiCインバータを用いた機一体インホイールモータ ・赤津 規(芝浦工大)				
16:45					
17:00	○シミュレーションドリブンによるEVの電源系、駆動系にお ける制御システムの設計 ・白石洋一(群馬大学)				

ポスターセッション第1日目(3月11日 14:30~15:30)

P11-01	金属イオン拡散を抑制する高信頼性半導体材料の開発と拡散抑制機構の検証(第2報)	○伏木 貴法1、孫 曉寅1、中山 紀行1、谷口 敏平1、彼谷 美千子1、國土 由衣1、橋本 慎太郎1、中村 奏美1	1.日立化成
P11-02	プリント基板実装UWBモノポールアンテナの小型化と群遅延特性に関する検討	○市川 舜太1、竹村 暢康1	1.日本工業大学
P11-03	放射部材向けシート状ナノ材料の紹介	○齊木 智秋1、矢野 亨1、斎藤 誠一1	1.ADEKA
P11-04	触覚情報フィードバックのためのウェアラブル振動デバイスの試作	○若林 克弥1、高松 誠一1、伊藤 寿浩1	1.東京大学
P11-05	Niマイクロメッキを用いた基板埋込型SiCパワーモジュールの評価	○宮崎 達1、山口 圭1、森迫 勇1、和田 佳子1、福森 稔1、飯塚 智徳1、巽 宏平1、糸瀬 智也2、匹田 政幸2、上村 力也3	1.早稲田大学、2.九州工業大学、3.北九州産業学術推進機構
P11-06	Cuボールを介したNiマイクロめっき接合による新実装方式の検討	○富士原 巧1、小野寺 巧1、田中 康紀1、森迫 勇1、和田 佳子1、飯塚 智徳1、巽 宏平1	1.早稲田大学
P11-07	グラビアオフセット印刷法により形成した微細銀グリッド配線に導電性ポリマーを積層したフレキシブル透明電極の電気・機械信頼性	○大沢 正人1、橋本 夏樹1	1.株式会社アルバック
P11-08	大気圧プラズマにより表面活性化した極薄Au薄膜による大気中常温ウェハ接合	○山本 道貴1、2、松前 貴司2、倉島 優一2、高木 秀樹2、三宅 敏広3、須賀 唯知4、伊藤 寿浩1、日暮 崇治2、4	1.東京大学大学院 新領域創成科学研究科、2.産業技術総合研究所 集積マイクロシステム研究センター、3.株式会社デンソー 基盤ハードウェア開発部、4.東京大学大学院 工学系研究科
P11-09	スルファミン酸浴を用いたNiマイクロめっき接合による最適めっき条件及び接合信頼性	JEONGBIN YOON 1、富士原 巧1、魏 星1、田中 康紀1、森迫 勇1、飯塚 智徳1、○巽 宏平1	1.早稲田大学大学院情報生産システム研究科

講演セッション 第2日目(3月12日)

	【A会場】	【B会場】	【C会場】	【D会場】
9:30			【高速伝送実装③】 12C1-01 多層プリント配線板で形成するパラボラアンテナにおける反射器サイズに対する利得の検討 ○松尾 佳樹1、越地 福朗1、越地 耕二2 1.東京工芸大学, 2.東京理科大学	
9:45			12C1-02 High-band UWB 単方向性円偏波平面アンテナの開発 ○甲斐 駿介1、金谷 晴一 九州大学	
10:00	【カーエレクトロニクス実装①】 12A1-01 二輪車用ECUパッケージングの進化 ○武田 裕一 本田技術研究所	【サーマルマネージメント&パワーエレクトロニクス実装①】 12B1-01 新規銀ナノ粒子ペーストによる高耐熱接合の開発 ○長澤 浩1、中島 啓光3、雨宮 隆2、伊藤 公紀1 1.株式会社 環境レジリエンス, 2.横浜国立大学, 3.電気通信大学	12C1-03 小型端末実装用非共振クロススロットペアを有するラジアルラインスロットアンテナ ○樋熊 康裕、常光 康弘 拓殖大学	【バウンダリスキャン設計】 12D1-01 バウンダリスキャンテスト回路を用いた待機モード時電気試験を可能にするTAPCの開発 ○池内 康祐、神田 道也、平井 智士、四柳 浩之、橋爪 正樹 徳島大学
10:15	12A1-02 端子用銅合金へのめっき処理によるアルミニウム電線のガルバニック腐食の防止 ○久保田 賢治1、玉川 隆士2、樽谷 圭栄1、中矢 清隆1、酒井 章雄1、川合 俊輔1 1.三菱マテリアル株式会社, 2.三菱伸銅株式会社	12B1-02 高温パワーサイクル試験による銀ナノ粒子接合材料の信頼性評価 ○八坂 慎一、田口 勇一、篠原 俊朗1 1.地方独立行政法人 神奈川県立産業技術総合研究所	12C1-04 ミリ波帯実装基板向けに適した一層構造導波管平面スロットアンテナ ○平田 眞真、常光 康弘 拓殖大学大学院	12D1-02 FPGAを活用したバウンダリスキャン教育システムの開発 ○土屋 秀和、大谷 秀吉、神戸 昂太、永尾 崇、浅川 毅 東海大学
10:30	12A1-03 先進運転支援システム、ADASにおけるMEMSミラーを用いた高忠実度な配光制御 ○櫻山 美奈、志村 祐貴、田中 源人、茂木 和弘、白石 洋一 群馬大学	12B1-03 焼結型銅接合材の開発とその信頼性評価 ○山口 朋彦1、乙川 光1、樋上 晃裕 三菱マテリアル株式会社	12C1-05 ガード・トレースによるコモンモード放射の抑制に関するシミュレーション分析 ○伊神 真一1、藤尾 昇平2 1.emデータサービス, 2.日本アイビーエム	12D1-03 TDC組込型バウンダリスキャン設計を用いる微小遅延故障検査における遅延ばらつき影響調査 ○菊池 悠也、新開 颯馬、四柳 浩之、橋爪 正樹 徳島大学
10:45	休憩			
11:00	【カーエレクトロニクス実装②】 12A2-01 モデルベースアプローチによるモーターバッテリー駆動回生システムに対する汎用シミュレータの開発 ○中田 志高1、青木 敦寛1、茂木 和弘1、白石 洋一1 群馬大学	【サーマルマネージメント&パワーエレクトロニクス実装②】 12B2-01 コアシェル型SnCu系TLP接合材の信頼性評価 ○岩田 広太郎1、樋上 晃裕 三菱マテリアル	【高速伝送実装④】 12C2-01 高速シリアルインターフェースのDCブロッキングコンデンサの伝送特性改善に関する一検討 ○橋本 樹明1、田中 大介1、三原 恭次1、牧田 和雄1、須藤 俊夫2 1.株式会社村田製作所, 2.芝浦工業大学	【部品内蔵技術①】 12D2-01 設計から考える部品内蔵基板のバウンダリスキャン導入時の課題と解決の方向性 ○松澤 浩彦1、古瀬 利之2 1.株式会社 図研, 2.図研テック 株式会社
11:15	12A2-02 汎用制御フレームワークを用いた自動搬送車(AGV)の開発 ○関根 智、松崎 航大、茂木 和弘、白石 洋一 群馬大学大学院理工学府	12B2-02 Zn混合ハイブリッド接合層の解析 ○佐藤 敏一、臼井 正則 豊田中央研究所	12C2-02 遺伝的アルゴリズムによる伝送波形の改善に関する研究 ○孟 東緒1、高橋 文博2、浪岡 美予子2 1.拓殖大学大学院, 2.拓殖大学	12D2-02 リジッドフレックスタイプ薄型部品内蔵基板の開発 ○秦 豊 太陽誘電株式会社
11:30	12A2-03 MBDを用いたスタック回避のためのスリッパ制御技術 ○青木 敦寛、茂木 和弘、白石 洋一 群馬大学大学院	12B2-03 Cuナノ粒子接合の放射光ラミノグラフィによる劣化観察 ○臼井 正則、佐藤 敏一、瀬戸山 大吾、上山 道明1、木村 英彦 豊田中央研究所	12C2-03 差動屈曲線路のミランダ配線による伝送特性の改善方法の検討 ○奈良 茂夫 富士ゼロックス株式会社	12D2-03 薄膜キャパシタ内蔵パッケージ基板の開発と製品化 ○赤星 知幸 株式会社富士通研究所
11:45	12A2-04 モデルベース開発による多脚歩行ロボットの歩行制御システムの開発 ○高村 哲太、志村 祐貴、田中 源人、白石 洋一、茂木 和弘 群馬大学	12B2-04 パワーデバイス向けNi-P合金めっきの高温加熱によるクラック発生メカニズム ○藤森 友之1、2、益井 哲也1、倉科 匡1、清水 雅裕2、新井 進2 1.大和電機工業株式会社, 2.信州大学	12C2-04 妨害波パラメータに対するEthernet通信のバケットエラーレートの変化 ○石橋 健太、松嶋 徹、福本 幸弘 九州工業大学	
	昼休み			
13:00	【カーエレクトロニクス実装③】 12A3-01 パワーモジュール用実装材料評価プロジェクト(KAMOME-PJ)の活動状況 ○山田 靖 大同大学	【サーマルマネージメント&パワーエレクトロニクス実装③】 12B3-01 ディスクリフトパワー半導体のパッケージ熱抵抗に関する研究 ○西 剛伺 足利大学	【ものづくりセッション(2)】 12C3-01 回路図設計段階でJTAGテスト容易化設計 ○浅野 義雄 富士設備工業株式会社	【部品内蔵技術②】 12D3-01 3Dプリンタを応用した立体回路基板の製造装置 ○富永 亮二郎1、長谷川 清久2、谷口 英俊3 1.株式会社FUJII, 2.株式会社図研, 3.図研テック株式会社
13:15		12B3-02 接触圧力分布を考慮した接触熱抵抗の測定手法の検討 ○青木 洋絵、平沢 浩一、中島 大誠、富村 寿夫 KOA株式会社	12C3-02 BGA基板の実装テストと故障解析の改善策-JTAGバウンダリスキャンテスト ○谷口 正純 アンドールシステムサポート株式会社	12D3-02 3Dプリンタを応用した立体回路基板のための設計フロー構築 ○長谷川 清久1、富永 亮二郎2、谷口 英俊3 1.株式会社図研, 2.株式会社FUJII, 3.図研テック株式会社
13:30	12A3-02 ミリ波帯におけるプリント基板の複素誘電率の温度依存性測定 ○高橋 一生、松井 亜紀子、安陪 光紀、長楽 公平 富士通アドバンステクノロジー	12B3-03 SiC擬似発熱チップを用いたパワーサイクル試験によるセラミック配線基板の放熱特性評価 ○若杉 直樹1、長尾 至成2、竹下 一毅1、金 東辰2、下山 章夫2、佐藤 直樹2、菅沼 克昭2 1.ヤマト科学, 2.大阪大学 産業科学研究所	12C3-03 CR-8000を活用した、設計部門と検査部門のバウンダリスキャン連携 ○松澤 浩彦1、古瀬 利之2 1.図研, 2.図研テック	12D3-03 三次元半導体研究センタープラットフォームC SIPOSIにおける部品内蔵基板開発の取組について ○野北 寛太 公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団 三次元半導体研究センター
13:45	12A3-03 平衡形円板共振器法を用いた測定ハードウェアの検討 ○長楽 公平、松井 亜紀子、安陪 光紀、高橋 一生 富士通アドバンステクノロジー	12B3-04 カートリッジ方式熱流定常比較法による実装基板の熱特性評価および信頼性検証 ○佐藤 直樹1、大串 哲朗2、若杉 直樹3、竹下 一毅3、陳 伝形1、長尾 至成1、菅沼 克昭1 1.大阪大学産業科学研究所, 2.アドバンスナレッジ研究所, 3.ヤマト科学株式会社		
14:30	14:30~15:00 表彰式 E館 記念講堂			
15:00	15:00~17:00 特別講演 ①「5Gによって加速するデジタル変革」 大和敏彦氏(株式会社アイティアイ) ②「自動車の電子化と車載半導体に求められるもの」 小野田 邦広氏(株式会社デンソー)			
17:30	17:30~19:00 交流会			

講演セッション 第3日目(3月13日)

	【A会場】	【B会場】	【C会場】	【D会場】
9:30		【ミニシンポジウム】 13B1-01 高速信号伝送のあり方 ○大塚 寛治1 1.明星大学		
9:45	【ヘルスケア】 13A1-01 超長寿命小型pHセンサに関する研究—バルブ液結型銀塩化銀参照電極の開発— ○樋口 昌吾、高松 誠一、伊藤 寿浩 東京大学	13B1-02 次世代コンピュータシステムに向けた実装技術の挑戦 ○増田 泰志 富士通アドバンステクノロジ	【信頼性解析技術①】 13C1-01 ECM研究会の発足から今日までの歩み ○津久井 勤 リサーチラボ・ツクイ	
10:00	13A1-02 畜産動物の心拍間隔計測のための非接触心音センサの検討 ○安藤 佳輝1、伊藤 寿浩1、小林 健2、高松 誠一1 1.東京大学大学院、2.産業技術総合研究所			
10:15	13A1-03 人間的性能を有した電動義手の開発 ○元行 勝大、奈良 颯、白石 洋一、茂木 和弘 群馬大学	13B1-03 400/800Gbps Ethernet時代に向けた低損失Flyover内部配線技術 ○水村 晶範 サムテック・ジャパン LLC	13C1-02 Air-HASTにおけるプリント基板のECMIによる寿命評価 ○岡本 秀孝	
10:30	13A1-04 脳嚙リスク低減のための舌運動能力診断システムの開発 ○竹井 裕介1、久嶋 智子2、外山 義雄2、館村 卓3、吉田 学1、小林 健1 1.産業技術総合研究所、2.明治、3.TOUCH Solution			
10:45	休憩			
11:00	【ヘルスケア】 13A2-01 静電植毛技術を用いた心電図測定用立体ドライ電極の作製と応用 ○竹下 俊弘1、吉田 学1、竹井 裕介1、大内 篤1、榎 顯成2、内田 広夫2、小林 健1 1.産業技術総合研究所、2.名古屋大学	【ミニシンポジウム】 13B2-01 データセンサを支える高速光信号伝送と実装技術 ○長島 和哉、那須 秀行 古河電気工業	【信頼性解析技術②】 13C2-01 ICT機器における実装の絶縁信頼性 ○高木 清1、2 1.サーキットネットワーク、2.高木技術士事務所	
	13A2-02 胸部装着型皮膚刺激情報提示デバイスに関する研究—電気刺激波形の設計条件及び乾式電極材料の検討— ○奥田 真司、海法 克享、高松 誠一、伊藤 寿浩 東京大学			
11:30	【マイクロエレクトロニクス実装技術①】 13A2-03 シリコンナノワイヤ機械物性のプロセス依存性 ○生津 資大、北村 遼太郎、成瀬 隼多 愛知工業大学	13B2-02 パッケージレベル光電気配線技術 ○中臣 義徳 京セラ	13C2-02 表面実装したセラミックPGAパッケージの熱サイクル耐性評価 ○篠崎 孝一 宇宙航空研究開発機構	
	13A2-04 導電性ペーストの導電率モデリングに関する研究—多種類の導体粒子を混合したモデルの構築— ○平岡 和記、高松 誠一、伊藤 寿浩 東京大学		13C2-03 電気・熱・応力連成モデルによるエレクトロマイグレーション劣化解析 ○加藤 光章、牛流 章弘、文倉 智也、大森 隆広、廣畑 賢治 株式会社東芝	
	昼休み			
13:00	【マイクロエレクトロニクス実装技術②】 13A3-01 味を測るための味覚センサの開発 ○田原 祐助 九州大学	【光回路実装技術①】 13B3-01 樹脂マイクロレンズ作製における形状再現性の向上及び形状制御の検討 ○桑原 大洋、藤川 知栄美、三上 修 1.東海大学	【システムインテグレーション実装技術】 13C3-01 有機インターポーザを用いた異種デバイス集積パッケージの開発 ○大井 淳、三木 翔太、小林 直生、種子田 浩志、宮入 健1、村山 啓、相澤 光浩、清水 規良、小山 利徳 1.新光電気工業株式会社	(一社)スマートプロセス学会 エレクトロニクス生産科学部会 ③ 有機/無機接合研究委員会 公開シンポジウム ① マルチマテリアルに向けた異種材料接合技術及び国際標準化動向(35分) 板橋 雅日(大成プラス(株))
13:15		13B3-02 Mosquito法 および 直接露光法によるシングルモードポリマー光導波路の作製と光学素子との高効率光結合検討 ○森本 祥江1、疋田 真2、松井 睦1、藤原 悠人1、石榑 崇明2 1.慶應義塾大学大学院、2.慶應義塾大学		
13:30	13A3-02 可動アイランド構造を有するフレキシブル基板への極薄シリコンチップ実装 ○竹下 俊弘、竹井 裕介、武井 亮平、大内 篤、小林 健 産業技術総合研究所	13B3-03 高密度オンボード光配線のためのシングルモード/マルチモードポリマー交差光導波路 ○藤原 悠人1、石榑 崇明2 1.慶應義塾大学 大学院、2.慶應義塾大学	13C3-02 ハンブウェル用バックグラウンドテープの開発 ○小舟 雄一朗、前田 淳、田久 真也 リソテック	② 異材料接合体強度と破壊様式に及ぼす界面形状の影響(仮) 立野 昌義、徳元 繁一、村岡 俊輔(工学院大学)
13:45	13A3-03 低沸点媒体を作用流体に用いた小型ランキンサイクル発電機の検討 ○金子 美泉、工藤 和也、岡嶋 航、田中 勝之、内木場 文男 日本大学	13B3-04 モスキート法によるシングルモード導波路作製ならびに多段化コア配列の基礎検討 ○矢加部 祥1、2、松井 睦2、石榑 崇明2 1.住友電気工業株式会社、2.慶應義塾大学	13C3-03 3D-TSV積層に向けた高生産性ハンブ貫入接続技術 ○福住 志津、小野関 仁、鈴木 直也、野中 敬央 日立化成株式会社	
14:00	13A3-04 制御回路及び小型電池を搭載した6足MEMSマイクロロボットの検討 ○野口 大輔、早川 雄一朗、河村 豊史、田中 泰介、小川 元輝、金子 美泉、齊藤 健、内木場 文男 日本大学理工学部	13B3-05 ポリマー光導波路を用いた光量制御—光回路設計による光分配・光減衰— ○木下 遼太、寺田 信介、兼田 幹也 住友ベークライト株式会社		③ 隆起微細構造を用いた金属—プラスチック直接接合の可能性(35分) 前田 知宏(輝創(株))
14:15	13A3-05 マイクロロボット用の双方向に駆動力をもつ静電リニアモータの開発 ○平尾 聡志、仲田 友也、長田 元氣、水本 明日也、金子 美泉、内木場 文男、齊藤 健 日本大学			④ 有機/無機接合界面の分析手法(35分) 泉 由貴子((株)東レリサーチセンター)
	休憩			
14:45	【マイクロエレクトロニクス実装技術③】 13A4-01 極薄MEMS、回路チップの三次元積層化技術 ○小林 健、竹下 俊弘、牧本 なつみ 国立研究開発法人産業技術総合研究所	【光回路実装技術②】 13B4-01 SC形マルチコアファイバ用光コネクタの接続特性 ○今泉 可津貴、長瀬 亮 千葉工業大学	【インテリジェント実装設計技術】 13C4-01 遠伝的アルゴリズムを用いたPCB用超高速配線の試作設計 ○松本 昂、松岡 駿平、大平 哲也、星野 裕哉、安永 守利 筑波大学大学院	
15:00	13A4-02 薄いa-Ge及びa-Si薄膜を用いた原子拡散接合法によるウエハ室温接合 ○村岡 有菜、魚本 幸、鳥津 武仁 1.東北大学	13B4-02 共鳴反射と入力結合の波長を一致させた共振器集積導波モード共鳴フィルタ ○楠浦 俊樹1、辻 篤史1、井上 純一1、滝下 直人1、金高 健二2、西尾 謙三1、妻 升吾1 1.京都工芸繊維大学、2.産業技術総合研究所	13C4-02 自己回帰を持つニューラル回路を実装した4足歩行ロボットの自発的な歩容の生成 ○宮増 優樹、武井 裕樹、森下 克幸、田澤 陸、金子 美泉、内木場 文男、齊藤 健 日本大学	
15:15	13A4-03 接合中間層がLNOI光導波路特性に及ぼす影響調査 ○多喜川 良1、日暮 栄治2、3、浅野 雅正1 1.九州大学、2.産業技術総合研究所、3.東京大学	13B4-03 チップスケールSiフォトニクス・トランシーバにおけるレーザー・ダイオード封止工程 ○竹村 浩一1、栗原 充2、清水 隆徳1、木下 啓蔵2、中村 隆宏1、蔵田 和彦2 1.技術研究組合光電子融合基盤技術研究所、2.アイオーコア株式会社	13C4-03 利用者の意図を推測する情報検索システムの開発 ○林田 拓海、茂木 和弘、白石 洋一 群馬大学	
15:30	13A4-04 高性能X線検出器のための表面活性化接合によるSn吸収体/A超伝導トンネルジャンクション構造の常温複合化 ○松前 貴司、倉島 優一、日暮 栄治、藤井 剛、浮辺 雅宏、高木 秀樹 産業技術総合研究所	13B4-04 小型フォームファクタ集積53Gbit/s/ch PAM4光アクティブケーブル ○高武 直弘、高井 俊明、中條 徳男 株式会社日立製作所	13C4-04 機械学習のアプローチによるチップ部品画像の重心検出とそのFPGA実装 ○中村 匠吾1、相部 範之1、金澤 健治2、安永 守利1 1.筑波大学、2.慶應義塾大学	
15:45	13A4-05 光ナノインプリント樹脂への凝縮性ガスの溶解性の評価 ○鈴木 健太、尹 成園、廣島 洋 産業技術総合研究所		13C4-05 ディープラーニングに基づく製品の外観検査のための効率的なセグメンテーションアルゴリズム ○ALANKARAGE SAMPATH NISSANKA KUMARASINHE、Nakajima Ayana、Kazuhiro Motegi、Yoichi Shiraiishi 群馬大学	
16:00			13C4-06 機械学習における不均衡データに対する分類方法と特徴量の調整方法 ○岡 大輔、茂木 和弘、白石 洋一 1.群馬大学大学院	